

お客様各位

平成19年10月9日

富士電機デバイステクノロジー(株)
半導体事業本部長

ゼットラップの保守品及び廃型化移行ご案内

拝啓、貴社益々ご隆昌の段、大慶に存じます。
平素は弊社半導体製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、掲記の件、長らくご愛顧を賜りました、弊社サージ保護素子である「ゼットラップ」につきまして弊社事業改革の一環として、機種戦略の変更を実施致します。
つきましては、誠に恐縮でございますが、本対象型式を保守化・廃型化移行させて頂きたくご理解、ご容赦頂きたくお願い致します。
尚、今後とも弊社半導体製品の相変わりにせぬご愛顧と引き続き旧倍のご厚情を賜りたく、伏してお願い申し上げます。

敬具

記

- 1) ご案内内容； 下記サージ保護素子「ゼットラップ」の保守品移行及び廃型
- 2) ご案内背景； ① 事業構造改革の実施
② 生産設備老朽化による安定供給困難化
- 3) 保守品化・廃型対象型式； ゼットラップ全型式
- 4) 保守・廃型移行実施時期；
① 保守品移行： 2007年10月15日～
② 最終出荷時期： 2010年09月末まで
- 5) 添 付 ① [保守・廃型対象型式一覧表](#)
② [他社類似品一覧表](#)

尚、詳細は弊社営業窓口までお問合せ下さい。